

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司健康可持续发展，于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所披露了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》，并于 2025 年 8 月 21 日披露了《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。2025 年度，公司根据上述行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好资本市场形象等方面取得了一定成效。2026 年，公司将结合自身发展战略和经营情况，制定 2026 年度“提质增效重回报”行动方案，我们将持续以规范的公司治理为基石，不断创造企业价值，精进经营管理水平，高度重视股东回报，恪尽上市公司职责，致力于构建更加积极、健康的投资者关系生态。现将 2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦主营业务，实现高质量发展，以优异的业绩回报投资者

2025 年，受益于新扩产能落地、高强度研发投入、测试产品结构优化、产能利用率不断提高等原因，公司 2025 年营业收入逐季提升，并在第四季度创出单季度营收历史新高。2025 年全年实现营收 157,464.24 万元，较上年同期增长 46.22%。2026 年，公司将继续积极聚焦主营业务，提升科技创新能力，继续加大研发投入力度，不断提升测试服务质量，夯实市场领先地位。我们将紧密跟踪行业前沿技术动态，突破高端测试研发痛点。同时，公司将进一步完善内部管理体系，优化运营流程，通过精细化管理和数字化升级，有效控制成本并提升效率。我们致力于以更可靠、高效的测试解决方案满足客户多元化需求，持续巩固和扩大市场份额。通过多维度协同发力，公司将全面提升核心竞争力、盈利能力以及行业内口碑，实现高质量、可持续发展，最终以优异的业绩和长期价值回报投资者的信任与支持。具体包括以下几个方面：

（一）继续贯彻“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车

规级及高算力产品测试”的发展策略，积极把握国产替代及下游战略新兴行业的发展机遇，实现公司业绩快速增长

公司是第三方集成电路测试行业中规模最大的内资企业之一，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。2025年，伟测半导体无锡集成电路测试基地项目（无锡项目）、伟测集成电路芯片晶圆级及成品测试基地项目（南京项目）均已投入使用，成功承接了AI、高性能计算、智驾等领域的高端测试需求，直接带动了高端测试业务占比显著提升，实现公司业绩快速增长。2026年，公司继续坚持“以中高端晶圆及成品测试为核心，积极拓展工业级、车规级及高算力产品测试”的发展策略，聚焦高算力芯片（CPU、GPU、AI、FPGA）、先进架构及先进封装芯片（SoC、Chiplet、SiP）、高可靠性芯片（车规级、工业级）的测试需求，积极把握国产替代及AI、新能源汽车、工业控制等战略新兴产业的发展机遇，实现公司业绩的快速增长，以优异的业绩回报投资者，致力于成为国内领先、世界一流的集成电路测试服务及解决方案提供商。

（二）积极推进投资项目，扩大测试产能，加快上海总部基地、成都项目的建设，为公司业绩的持续增长奠定产能基础

2025年，公司在南京和无锡的募投项目已投入使用，这不仅标志着公司产能布局的战略升级，更为全年业绩增长提供了坚实有力的产能保障。两大测试基地通过引入先进的生产设备与智能化管理系统，显著提升了公司在晶圆测试及芯片成品测试领域的服务效率与交付能力。依托长三角地区完善的集成电路产业生态，新产能的释放将有效缓解高端测试资源紧张的瓶颈，助力公司快速响应工业级、车规级及高算力芯片客户的旺盛需求，为后续市场份额的持续扩大奠定扎实基础。

2026年，公司将全力推进上海总部基地建设 with 整体扩产计划，加强公司市场竞争力和综合实力，有效降低运营成本，提升公司整体形象、公司管理效能和资源整合能力，重点加码“高端芯片测试”和“高可靠性芯片测试”领域的产能布局。此举旨在为我国集成电路测试的自主可控提供坚实保障，有力支撑人工智能、新能源电动车、自动驾驶及高端装备等下游战略新兴产业的快速发展。

（三）继续加大研发投入力度，为公司的快速发展提供技术支撑

2025年，公司研发费用为17,201.10万元，较上年同比增长20.81%，占营业收入的比重为10.92%。2025年完成18个研发项目，其中重点开发车规级SOC芯片的晶圆及成品测试方案，确保芯片的功能、性能和可靠性；利用93K和Chroma平台开发新兴5.5G射频前端芯片晶圆的测试方案；针对Chiplet对测试的挑战，不断开发新的测试技术和测试方案；通过芯片UID实现测试全流程参数的实时追踪与回溯，精准定位测试异常，提升问题排查效率，保障测试数据可追溯性，为高功率芯片质量管控提供数据支撑，满足汽车电子、工业控制等领域对测试数据溯源的严苛要求，助力高可靠性芯片产品研发与量产以及构建J750与OPUS测试机台的协同工作机制，实现数据共享与任务协同，提升多机台联合测试的效率和一致性，提高测试产线的整体产能。公司正凭借其前瞻性的技术布局，在芯片测试领域构筑起宽广的“护城河”，其强大的技术开发能力与落地效率，为公司未来的业绩增长注入了强劲的确定性。

公司采取阶梯式培养研发储备人员的培养方式，持续加大研发人员培养力度。截至2025年末，公司研发人员数量522人，占2025年末公司总人数的19.53%，2026年，公司将继续加大研发人员的内部培养和外部招聘，储备研发人才。

2026年，公司将继续加大高算力芯片、车规及工业级高可靠性芯片等领域的研发力度，在测试方案开发、底层测试技术突破、生产自动化等细分方向持续开展技术积累和技术突破，为公司的快速发展提供技术支撑。我们将继续紧跟技术前沿，发挥高端产能的规模效应与技术协同效应，努力为投资者创造更大价值。

（四）积极开拓市场，不断提升市场占有率

公司现有客户已经超过200家，不乏国内知名的集成电路设计公司，以及部分晶圆厂、封装厂及IDM公司，经过数年发展，公司已与广大客户建立了长期稳定的合作关系，客户基础稳固。为广泛拓展市场、深挖潜在客户，公司2025年积极参与“2025集成电路发展论坛（成渝）暨三十一届集成电路设计业展览会（ICCAD-Expo 2025）”和“SEMICON/FPD China 2025”进一步提升品牌曝光度，强化品牌形象，提升市场覆盖范围。2025年3月26日，公司成功举办“DEEP SEEK FOR ZERO-DEFECT”技术论坛，首次发布公司“在线侦测-大数据根因追

溯-量产实时卡控”技术闭环，实现从缺陷发现到产线拦截的全流程智能化，为下游客户提供稳定的交付能力。现场多家头部车规芯片企业认为该技术将加速其产品上车与规模化量产，为公司开拓高端市场、深化客户合作注入强劲动能。

未来公司将继续积极组织技术交流活动，提高行业影响力，加大市场的开拓力度，积极拓展境内境外客户，以更优质的测试服务、更高效的测试效率、更先进的测试水平提升公司在集成电路测试市场的占有率，更好地服务客户以及回报广大投资者。

二、完善公司治理，保障公司规范运作和可持续发展

2025年，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》的相关规定，并认真学习《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司于2025年9月9日召开了2025年第三次临时股东会，会议审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司参考《上市公司章程指引（2025年修订）》对公司章程及现行相关制度的部分条款进行修订完善，进一步规范了“关键少数”行为，提升治理水平，完善董事、高级管理人员任职、履职和离职管理制度，健全公司激励约束机制，规范控股股东、实际控制人行为。进一步加强了对信息披露暂缓与豁免行为的监管，保护投资者的合法权益。

2026年，公司将持续完善公司治理能力建设和内部控制制度，按照《上市公司治理准则》等要求，积极推进《公司章程》的修订和法人治理改革，持续完善公司现代法人治理结构和治理体系；促进规范运作，提升治理水平

2026年，公司将及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，并提交相关文件，为独立董事开展工作提供便利，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的监督作用，深化独立董事制度改革，不断强化独立董事履职保障，发挥独立董事监督、决策和咨询作用，持续提高董事会的科学决策水平。

2025年，公司董事、高级管理人员均参与了由上海上市公司协会组织的“上海辖区2025年上市公司董事、高管培训班”，各独立董事完成了独立董事后续培

训，公司董事会秘书王沛完成了两期上市公司董事会秘书后续培训。2026 年公司将继续积极组织董事、高级管理人员参与上海证券交易所、上市公司协会及证监局组织的各类培训，加强学习证券市场法律法规，不断提升合规意识和风险意识，推动公司规范运作。

三、提高信息披露水平，加强投资者沟通，积极传递公司投资价值

2025 年，公司完成四次定期报告和 96 次临时公告的披露，为投资者的价值判断提供了充分依据。报告期内，公司接听投资者热线 200 余次，回答 e 互动问题 140 条，召开了 3 次业绩说明会，并组织了两天的无锡新厂投资调研活动，与投资者保持良好沟通，与投资者形成良性互动，及时听取投资者建议，回应投资者诉求。

2026 年，公司继续通过“上证 e 互动”、投资者热线、公司邮箱、业绩说明会、电话会、网上路演等形式与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据及公司未来发展战略。2026 年公司计划举办不少于 3 次业绩说明会，通过组织投资者参观活动，邀请投资机构、分析师及有兴趣的投资者，现场参观公司的生产线、办公区域，更加直观、贴近感受公司的文化，组织公司高管和相关部门负责人与投资者进行沟通；通过积极参加各家卖方机构组织的策略会，与各类投资者进行面对面交流，并根据投资者需要，安排公司现场调研、反路演等多种形式的投资者沟通交流，深入了解投资者的实际诉求，并做出及时回应。

四、完善投资者回报机制，继续保持不低于 30%的现金分红比率，提升公司投资价值

公司自 2022 年上市以来重视对投资者的回报，公司坚持实行持续、稳定的利润分配政策，公司重视投资者的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展，根据公司的盈利情况、现金流情况以及未来发展战略规划等因素，制定合理的利润分配方案。公司在《公司章程》中明确了公司现金分红政策并严格执行，十分重视对股东的投资回报收益。

2025年，公司坚持合理回报股东，利润分配政策保持持续性和稳定性，兼顾实际经营与长期战略目标。公司于2025年6月18日完成现金红利分派，共分派38,814,330.30元，现金分红占2024年度归属于上市公司股东净利润的30.27%。自2022年10月26日在科创板上市至2025年末，公司已累计现金分派约1.49亿元。

2026年，公司将继续实施现金红利分派，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币5.50元（含税），预计分配现金红利总额为92,270,563.55元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.43%。公司将在股东会审议通过相关方案后尽快实施。

五、强化管理层与股东的利益共担共享约束

（一）制定与经营业绩相挂钩的高管薪酬政策

2025年，公司高级管理人员的薪酬政策与公司的经营情况相挂钩。公司高级管理人员薪酬由基本工资、绩效奖金和年终奖金等组成，同时公司根据每月度的营业收入情况制定月度营业收入奖金。根据每月的公司经营情况，结合个人及主管部门的业务情况，确定高级管理人员的绩效奖金。绩效奖金及年终奖金均与公司业绩及个人绩效完成情况挂钩。

2026年，公司将根据《上市公司治理准则》规定，修改薪酬管理制度，包括工资总额决定机制、董事和高级管理人员薪酬结构、绩效考核、薪酬发放、止付追索等内容。上市公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。公司依据经审计的财务数据开展绩效评价，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

（二）通过业绩考核强化股权激励约束机制

最近3年公司每年均开展了限制性股票激励计划，实现公司高级管理人员及核心团队成员的利益和公司股东利益的捆绑，共同推进公司发展。激励计划均选取了营业收入作为公司层面业绩考核指标，公司对所有激励对象个人还设置了合理的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。

上述激励计划有利于公司进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的方案，未来可能会受到宏观政策调整、集成电路行业波动情况、二级市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将在积极履行本行动方案的基础上，持续评估实施本方案的相关举措，努力通过优良的经营业绩、规范的公司运作、积极合理的投资者回报，切实履行上市公司的义务，承担作为上市公司的职责，努力回馈广大投资者的信任，实现公司的价值。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026年4月22日